

KING
Solution Corp.

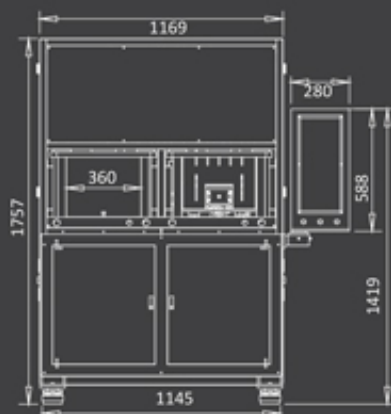
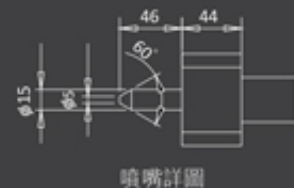
極低射出壓力：
20-500Psi (1.5-35Bar)，
取代Epoxy灌注/點膠製程
以保護脆弱的電子元件，
封裝電線和連接器
比以往無壓力灌注的方式
更密合，
且不破壞元件。



雙工位低壓成型機
Dual Injection
Low Pressure Molding Machine



Dual Injection Low Pressure Molding Machine



- 全機動力採氣壓和單向電，節能減碳，方便於一般無塵室，潔淨室，實驗室使用。
- 洩壓裝置設計，機械式與氣動式調壓閥，成型壓力可以調整。
- 2段控溫(熔料缸及射嘴)，可獨立控制。
- 熔料缸鐵氟龍鍍膜，加熱均勻快速，方便清料。
- 熔料缸與射嘴同動，氣動座進退。
- 射嘴直接和齒輪泵連接、無保溫管，減少碳化與結晶。
- 兩柱型設計，適合小型零件成形，操作方便。
- 為使用者安全，配備安全光幕和雙手同時啟動按鈕、全機封板。
- 工業電腦Linux核心系統，多語言切換PC Base。
- 可儲存1000套模具參數設定資料。
- 異常紀錄、歷史紀錄存查、USB匯入/匯出。
- 客戶可以透過機台控制器連上網路，直接線上檢修機台。

